



客户宝号: _____

规格书

品名规格: T10A-BSBN-10.00MHz

出 图			确 认 印
制 图	审 核	核 准	请予确认签章 谢谢!
			
日期: 09年 08月 05日			

东莞市大普通信技术有限公司

东莞市松山湖科技园新城大道1号

TEL: 0086-0769-88010888 FAX: 0086-0769-81800098



产品技术参数指标

型号: T10A-BSBN-10.00MHz

1. 输出

- 1.1. 频率 10.00MHz
- 1.2. 波形 正弦波, 峰-峰值>1.0V, 带载 50Ω, 输出功率≥5dBm
- 1.3. 杂波 ≤65dBc
- 1.4. 谐波 ≤30dBc

2. 频率稳定度

- 2.1. 温度特性 ≤±1.0x10⁻⁶ @-40°C ~ +85°C, @25 °C
- 2.2. 频率准确度 ≤±1.0x10⁻⁶ @25°C, 出厂时校正
- 2.3. 电源特性 ≤±5.0x10⁻⁷ @5.0VDC±5%
- 2.4. 负载特性 ≤±5.0x10⁻⁷ @Load±5%
- 2.5. 老化率 ≤±2.0x10⁻⁸/日
≤±1.0x10⁻⁶/第一年

3. 电压

- 3.1. 工作电压 5.0V±5%

4. 电流

- 4.1. 工作电流 5mA(Typical) @25°C

5. 相位噪声(Typical)

- 5.1. 1KHz -135dBc/Hz

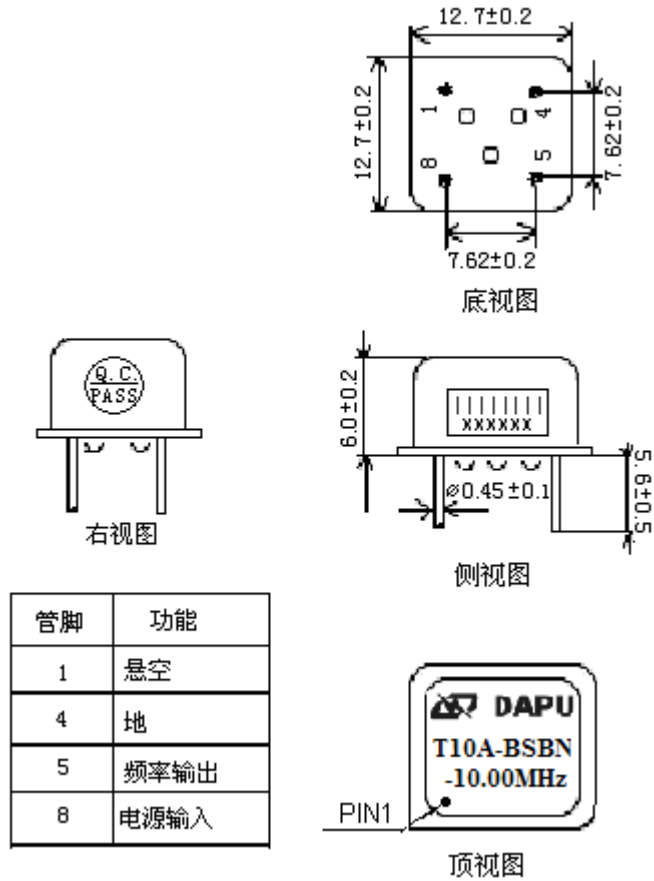
6. 环境特性

- 6.1. 工作温度 -40°C ~ +85°C
- 6.2. 存储温度 -55°C ~ +105°C
- 6.3. 振动 测试条件: 振幅1.50mm (10~55Hz)
30分钟一个循环(3个方向, X,Y,Z)
- 6.4. 冲击 5cmsec, 3个方向, 每个方向3次
- 6.5. 下坠 从75cm高度下坠到硬木板上
- 6.6. 保存 从包装盒取出之后, 建议保存条件为: 温度30°C, 湿度70%



7. 机械结构:

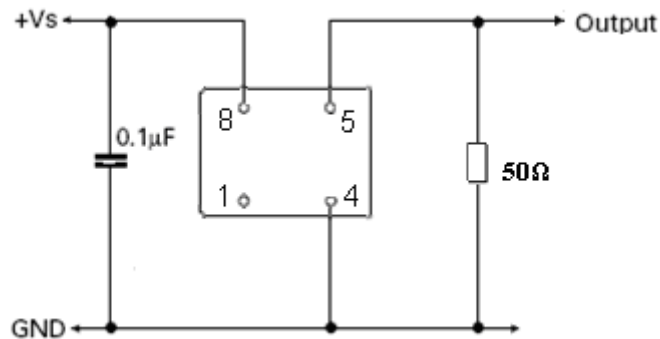
7.1. 外形尺寸及管脚定义



注：底视图为针脚正对着观察者

单位：mm

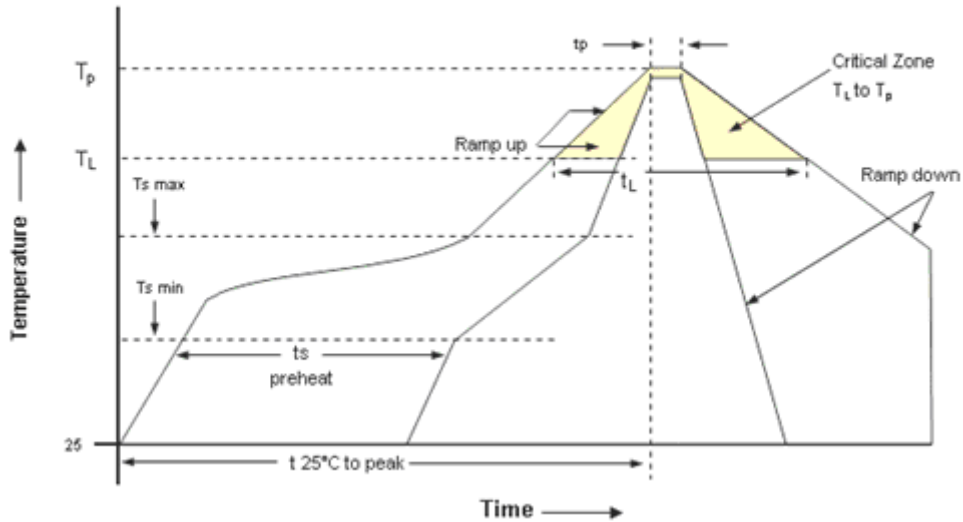
8. 测量电路





9. 波峰焊曲线图

Solderprofile:



Profile Feature	Pb-Free Assembly	Profile Feature	Pb-Free Assembly
Average ramp-up rate (T _L to T _p)	3°C/second max.	Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.
Preheat -Temperature Min T _{s min}) -Temperature Min T _{s max}) -Time (min to max) (t _s)	150°C 200°C 60-180 seconds	Time maintained above - Temperature (T _L) - Time (t _L)	217°C 60-150 seconds
T _{s max} to T _L - Ramp-up Rate	3°C/second max.		
Time maintained above - Temperature (T _L) - Time (t _L)	217°C 60-150 seconds	Time within 5°C of actual Peak Temperature (t _p)	20-40 seconds
Peak Temperature (T _p)	max 260°C	Ramp-down Rate	6°C/second max.

Note: All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.